

GABINETE DO MINISTRO
PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 72, DE 22 DE MARÇO DE 2011

OS MINISTROS DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO EXTERIOR E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA, no uso das atribuições que lhes confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição Federal, tendo em vista o disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991, no § 1º do art. 2º, e nos artigos 16 a 19 do Decreto nº 5.906, de 26 de setembro de 2006, e considerando o que consta no processo MDIC nº 01200.007092/2001-54, de 14 de janeiro de 2002, resolvem:

Art. 1º Os Processos Produtivos Básicos para os produtos CARTÕES INTELIGENTES (smart cards), industrializados no País, estabelecidos pela Portaria Interministerial MDIC/MCT nº 15, de 20 de janeiro de 2009, passam a ser os seguintes:

I - CARTÕES INTELIGENTES COM CONTATO - LAMINADO:

- a) fresamento da cavidade do cartão plástico;
- b) separação e preparação do módulo do circuito integrado monolítico ou microchip;
- c) aplicação do adesivo na cavidade do cartão; e
- d) fixação do módulo do microchip no cartão.

II - CARTÕES INTELIGENTES COM CONTATO - INJETADO:

- a) injeção plástica do cartão;
- b) separação e preparação do módulo do microchip;
- c) aplicação do adesivo na cavidade do cartão; e
- d) fixação do módulo do microchip no cartão.

III - CARTÕES INTELIGENTES SEM CONTATO:

- a) fresagem da folha de PVC (formação do calço);
- b) impressão das folhas de PVC, quando aplicável;
- c) montagem do microchip na antena; e
- d) fusão (laminação) do conjunto calço, antena, folhas de PVC e folha de cristal de PVC.

§ 1º Todas as etapas dos Processos Produtivos Básicos acima descritas deverão ser realizadas no País.

§ 2º Desde que obedecidos os Processos Produtivos Básicos, as atividades ou operações inerentes às etapas de produção estabelecidas neste artigo poderão ser realizadas por terceiros, exceto as etapas estabelecidas nos incisos “c” e “d” dos incisos I e II e a alínea “d” do inciso III, que não poderão ser objeto de terceirização.

§ 3º A etapa estabelecida na alínea “a” do inciso II, referente à injeção plástica do cartão, deverá atender ao seguinte cronograma, tendo como base o percentual, em quantidade de cartões produzidos, no ano calendário:

I - De 1º de outubro de 2009 até 31 de dezembro de 2010: Dispensada;

II - De 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2011: 50% (cinquenta por cento); e

III - De 1º de janeiro de 2012 em diante: 90% (noventa por cento).

§ 4º Os cartões plásticos mencionados no inciso I deverão ser produzidos no País a partir da fusão das folhas plásticas.

Art. 2º Os circuitos integrados monolíticos mencionados nos incisos I, II e III do art. 1º deverão atender, a partir de 1º de janeiro de 2010, ao seguinte Processo Produtivo Básico, para um percentual mínimo de 50% (cinquenta por cento) da produção do ano calendário.

I - montagem de pastilha semicondutora, não encapsulada;

II - encapsulamento da pastilha montada;

III - teste (ensaio) elétrico ou optoeletrônico; e IV - marcação (identificação).

§ 1º Os circuitos integrados monolíticos ou microchips de que trata este artigo poderão ser adquiridos de terceiros, desde que cumpra o Processo Produtivo Básico estabelecido neste artigo.

§ 2º Excepcionalmente para o ano de 2010, caso o percentual referido no caput não seja alcançado, no todo ou em parte, a empresa fabricante ficará obrigada a cumprir a diferença residual em relação ao percentual mínimo estabelecido, em unidades produzidas, até 31 de dezembro de 2011, sem prejuízo das obrigações correntes de cada ano-calendário.

§ 3º Para os cartões constantes nos incisos I e II do art. 1º (cartões com contato), o disposto no caput deste artigo fica dispensado, até o limite de produção anual por empresa, de 5 (cinco) milhões de unidades, desde que esses cartões não sejam de aplicação em telefonia celular ou cartões de bancos.

§ 4º Para os cartões constantes do inciso III do art. 1º (cartões sem contato), o disposto no caput deste artigo fica temporariamente dispensado.

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º deste artigo poderá ser reavaliado a qualquer tempo, buscando compatibilizar o processo produtivo básico com a política governamental de apoio e atração de indústrias de componentes no País.

§ 6º As empresas deverão apresentar em até 6 (seis) meses, a contar da publicação desta Portaria, relatórios semestrais das ações efetivamente realizadas na localização dos potenciais fornecedores para o encapsulamento dos circuitos integrados, visando o cumprimento das etapas estabelecidas no caput deste artigo, ficando a efetiva implementação das ações limitada a 6 (seis) meses da data do término da dispensa.

§ 7º O não envio das informações acima citadas por parte da empresa, bem como o não cumprimento dos dispositivos estabelecidas neste artigo caracterizará o não cumprimento do Processo Produtivo Básico, ficando a empresa sujeita às penalidades

previstas no art. 9º da Lei no 8.248, de 1991 e no art. 36 do Decreto no 5.906, de 26 de setembro de 2006.

Art. 3º Sempre que fatores técnicos ou econômicos, devidamente comprovados, assim o determinarem, a realização de qualquer etapa dos Processos Produtivos Básicos poderá ser suspensa temporariamente ou modificada, por meio de Portaria conjunta dos Ministros de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior e da Ciência e Tecnologia.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 5º Fica revogada a Portaria Interministerial MDIC/MCT no 15, de 20 de janeiro de 2009.

FERNANDO DAMATA PIMENTEL

Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior

ALOIZIO MERCADANTE OLIVA

Ministro de Estado da Ciência e Tecnologia